券代码：300493.SZ 证券简称：润欣科技

**上海润欣科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2016-002

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **单位** | **姓名** | **单位** | **姓名** | | 华创证券 | 张健 | 沃珑港 | 段中元 | | 南土资产 | 陈韫中 | 富敦投资 | 孙通 | | 中泰证券 | 李和瑞 | 浙商证券 | 唐光英 | | 浙商证券 | 陈俊杰 | 中银国际 | 朱超彦 | | 东方汇富 | 倪丹平 | 中银国际 | 吴彤 | | 东方汇富 | 王小东 | 中银国际 | 程燊彦 | | 南方基金 | 郑小溪 | 农银汇理 | 刘攀 | |
| **时间** | 2016年4月19日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书 庞军 财务负责人 胡惠玲  证券事务代表 刘一军 财务经理 孙剑 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、公司董秘庞军先生介绍公司情况**  上海润欣科技创建于2000年，公司是国内领先的IC产品授权分销商，分销的IC产品以通讯连接芯片和传感器芯片为主。目前主要代理高通创锐讯、恩智浦、AVX/京瓷、普思、新思、思佳讯等全球著名IC设计制造公司的IC产品，并拥有中兴康讯、共进电子、大疆创新等客户，是IC产业链中连接上下游的重要纽带。  公司总部位于上海市徐汇区，在北京、深圳、香港、台湾等地设有研发机构和分/子公司。2015年销售额超过10亿元人民币。  **二、投资者交流互动**  Q1：贵公司对物联网芯片的划分是怎样的？  答：物联网连接万物， 需要通过传感器采集存贮数据并上传到云端。从物联网的基础技术划分，我们把物联网芯片划分为：无线连接芯片、传感器芯片、安全控制类芯片。  Q2：公司代理新思芯片，每年的出货量大概是多少？  答：公司每年销售的新思芯片超过1000万片，过去两年销售的主要的是触控类芯片，从今年开始有做指纹识别。  Q3：公司是否有代理汇顶公司的芯片？一个团队是不是只能代理一家公司的芯片？  答：公司没有代理汇顶公司的芯片，因为它和新思是竞争对手，授权代理商的一个团队通常只能分销几条竞争产品线中的一条线。  Q4：公司的增速主要是基于行业的增速还是基于我们获得的市场份额？  答：这跟我们的芯片供应商有关，我们的供应商相对比较有竞争力，在智能手机领域的话，高通排名第一，竞争力较强，增速一般会快于其他供应商；恩智浦，在微处理器、汽车电子、安全控制方面具有优势，份额很高。  Q5：高通智能手机的全球出货增速并无大的增长，而我们的预期增长是否受影响？  答：高通智能手机的基带和处理器芯片，涉及专利授权费， 通常采用直供的方式。高通公司除了做手机基带等核心芯片外，还专门成立物联网部，将处理器应用于物联网上，如无人机、车联网、无线IP摄像头等，我们的业务主要集中在高通平台的外围芯片上。  Q6：国内市场是否更有发展空间？  答：现在国家的芯片自有化率不高，大概不到10%，而日本、韩国、台湾等电子加工业发展到中后期自有化率会达到30%左右，国家的“十三五规划”把信息安全、提高制造业芯片国产化率作为基本国策，鼓励自主研发，支持海外并购重组，给中国本土的分销商带来了很大的发展机会。  Q7：如何从高通这样芯片设计公司手里拿到定价权？  答：IC行业分工很细，产业链扁平化，国外领先的半导体设计公司一般只对行业领先的大客户提供技术支持和商务支持。一些创新型的小公司很难从芯片供应商得到技术支持和很优惠的价格。润欣作为本土的芯片分销商，可以在一个细分行业和应用上集合很多家客户，集腋成裘，用大量的订单增加议价能力，帮中小客户申请到优惠的价格。  Q8：公司和力源信息相比有什么优势？  答：公司在业务类别上和力源信息有差别，从定位上说力源信息是目录分销商，我司是技术分销商，从芯片数量、客户数量、产品集中度来说都有较大的差别。目前力源也在通过购并重组向技术分销方向发展。  Q9：公司在技术分销领域的市场份额如何？  答：公司近几年一直是属于中国本土十大IC分销商，我们只是在某一个细分领域做的比较深，有一定的份额，而相对于整个中国市场总容量（上万亿），我们还有很大的成长空间。  Q10：公司产品提供技术和服务内容的芯片所占的比重是多少？  答：公司需要提供设计方案的芯片销售占整个公司销售额的70%左右。  Q11：芯片的良率是多少？  答：从我们以往的经验来看，芯片的良率非常高，基本没有出现过比较大的质量问题，如果出现问题并定位是芯片质量问题的话，可以通过RMA流程向供应商申请退换。  Q12：IC行业比较分散，国外有一些很大的分销商，是通过并购扩展，公司是不是未来也会走这条路？并购是不是能够弥补分销行业的缺陷？  答：公司的发展都是有历史原因的，国际著名的半导体分销商都是经过了三十年以上的发展，跟着半导体行业发展起来的，资本体量很大，有很多产品线。并购是不是能够弥补分销行业的缺陷，这取决于最终的发展趋势，这几年芯片行业并购重组频繁，如果在上游稳定的情况下，并购会优化产品结构，扩大体量，但是上游不够稳定的情况下，就不一定。  Q13：现在并购有横向的，并购同行业的，还有是纵向的，往上游或者下游并购，公司是什么打算呢？  答：对于并购，公司还在研究，至于是向上并购还是向下并购还没有确定。公司刚刚进入资本市场，对于外延式发展，在公司发展到一定阶段，在条件和时机成熟时，会考虑通过并购的方式整合外部资源，优化企业的产品结构，实现快速增长和资源优势互补，提升自己的客户资源和技术服务能力。  Q14：如何看待线上分销模式？  答：线上分销模式很早就存在了，并不是这几年的新兴模式，一些国外的分销商已经做的很好，但是其业务模式和我们不一样，它取决于芯片供应和客户碎片化，相对来说，对技术支持的含量要求不是很高。  Q15：分销商的存在是因为上游厂商多、下游客户多，原厂无法直接满足所有客户的需求，而现在客户的技术能力在提高，那未来会不会出现原厂避开分销商去直接服务客户？如果这样会不会压缩到分销商的份额？  答：现在的客户技术能力是在提高，原厂也会对国内一些技术实力强的大客户提供直接的技术支持。而如果原厂要对客户直接提供技术服务的话，需要配备与分销商差不多数量的技术人员，从成本上来说，原厂是需要考虑成本的。而客户的技术能力也是原厂考虑是否直接提供技术支持的因素。  Q16：作为分销商，公司是否考虑通过并购扩大自己的规模，通过协同效应和规模效应来扩大自己的服务范围？  答：国外一些分销商已经在协同效应和规模效应上做到了极致，在一些成熟的电子产品里，有的几乎可以涵盖产品95%的芯片，而我们还是会在公司擅长的领域专注、专业化。  Q17：资金强大对公司业务会有什么影响？  答：我们做芯片的运营也有备货周期和给客户的账期，资金规模对业务规模是有影响的，对于IC分销行业来说，对资金的需求量还是蛮大的。  Q18：公司要扩大规模的话，资金的需求量会很大，那接下来有没有继续融资等规划？是打算去并购竞争对手还是其他？  答：我们外延式的发展，如并购、重组等会做，但是须在公司发展到一定阶段，在条件和时机成熟时，并且得找到好的方向。这样公司才会通过并购使公司的产品结构更加合理。  Q19：授权经销商和非授权经销商的区别在哪里？  答：授权的门槛比较高，原厂不会轻易授权，授权基本是排他，国内的大中型客户基本都是由授权分销商支持的，没有授权是不能做的，而非授权经销商其实位于授权分销商的下游，也叫贸易商。原厂会根据客户对分销商进行非常严格的管控。  Q20：芯片厂商会给公司提供怎样的技术支持？  答：芯片原厂会有技术培训，一些内核资料和参考设计对我司是免费开放的，而对其他下游客户是收费的。  Q21：授权资格的取得是靠什么？销售额还是其他？  答：对于本土分销商来说，原厂主要还是看技术实力和价值，关键是要能给原厂创造较大价值。  Q22：IC行业的供货顺序是怎样的？  答：首先是行业前三名的产品及客户，提前半年左右去尝试，每一个细分行业，找1-2家，技术人员在客户进行为期半年的实践，后进行产品选择。接下来，是有发展潜力的重点客户，然后是向更广泛的客户群体推广。  Q23：一般，产品的研发周期多长？  答：消费类产品大概两年，手机类大概一年。  Q24：我们公司在广电EOC的份额是多少？  答：大概50%。  Q25：前段时间美国制裁中兴，对公司有无影响？  答：刚开始会有一些影响，但是后来问题解决了，事实上对我们影响不大。  Q26：芯片的产品化过程是怎样的？  答：芯片初期是比较基础的板，包含多种接口，而如何应用到产品上，需要根据客户的需求，将芯片推荐给客户，然后对芯片进行处理。客户对产品比较熟悉，而我们对我们分销的产品比较专业。  Q27：公司有多少人？有多少技术工程师？一个工程师可以支持几个项目？design in 到design win一般要多久？  答：公司共有180人左右，其中FAE、AE有60个左右。  在产品的开发过程中需要不同的专业技术人员进行支持，一般需要2到3个工程师一起，而在产品维护的后期基本上可由1名FAE工程师专门负责汇总和跟踪问题。  从design in 到design win一般要3个月左右。  Q28：公司上市后技术人员是否有增长？  答：上市后公司的技术人员有在增加，具体公司会根据市场和客户的增长情况，来调整人员规模和技术支持效率。  Q29：研发工程师的工作内容是什么？  答：研发工程师研发平台整体解决方案，每年会有3到5个自主研发的项目，在市场没有推开之前，没有可参考方案，就得靠研发工程师自己研发设计，将整个板从头到尾开发出来。今年我们在物联网上有几个研发方案。  Q30：对于无需提供技术支持的芯片的选择是怎样的？  答：无需提供技术支持的芯片可替代性比较大，一般都是客户自己选择。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2016-4-19 |